

## 智原科技公佈 2025 年第二季財務報告

第二季合併營收新台幣 45.1 億元，季減 39%，年增 70%

上半年累計合併營收超越去年全年，ASIC 委託設計新案數量創下同期新高

### 2025 年第二季合併財務報表摘要

- 營業收入為新台幣 45.1 億元
- 毛利率為 24.2%
- 歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 0.3 億元
- 基本每股盈餘為新台幣 0.10 元

台灣·新竹 – 2025 年 7 月 29 日 – 智原科技 (TWSE: 3035) · ASIC 設計服務暨矽智財(IP)研發銷售領導廠商，今日公佈 2025 年第二季合併財務報表，合併營收為新台幣 45.1 億元，季減 39%，年增 70%，毛利率為 24.2%，歸屬於母公司業主之淨利為新台幣 0.3 億元，基本每股盈餘為新台幣 0.10 元。

回顧第二季，本季的表現呈現多空交雜，既有來自外在因素的負面影響，也有來自業務發展的正面表現。第二季合併營收受到台幣升值及宏觀環境影響季減 39%，年增 70%，為新台幣 45.1 億元，上半年累計營收超越去年全年達新台幣 119.5 億元。以產品別來看，IP 營收受季節性認列波動影響季減 28%，年減 16%，為新台幣 2.9 億元，NRE 營收為 4.1 億元，季減 9%，年減 36%，主因先進製程案子認列時程調整，預期下半年會陸續認列。量產收入為新台幣 38.1 億元，季減 42%，年增 130%，主因先進封裝業務收入下降所致。第二季的營運環境雖有諸多逆風，但公司在業務拓展上的積極腳步並未放緩，上半年 ASIC 委託設計新案數量創下同期新高，除了成熟製程需求穩健，先進製程及封裝業務亦取得佳績。公司持續進行區域策略調整，並已於歐洲、美國及日本等區域取得先進製程設計案，上半年非中國區域佔比已過半，顯示公司推動區域市場多元化的策略已初見成效。在業務策略方面，AI 伺服器中，存、運、算三位一體，除了核心的「算」(如 XPU)，「運」與「存」的 ASIC 需求亦相當龐大。智原具備 SoC 設計與封裝協同規劃的能力，這項雙重價值讓公司在 AI 附屬晶片市場中享有設計與封裝的雙重商機。在封裝服務方面，公司於上半年成功取得多項封裝業務項目並於第二季簽下首項 3D 封裝專案，在當前國際規範之下，智原不僅具備 SoC 設計能力，更與晶圓廠及封裝廠保有緊密協作關係，提供客戶全方位的封裝整合服務與供應鏈協調，為客戶有效降低整合成本並加速專案開發時程。上半年公司已成功取得多個 AI 附屬晶片之設計項目，未來公司將持續深耕非中國市場，並以 AI 附屬應用為重點發展方向。

展望第三季，儘管整體營收預期較上季下降，然 IP 及 NRE 收入可望較上季增加並創下佳績。展望未來，在 AI 擴張浪潮之下，國際市場對 AI 附屬晶片的需求多樣化，智原將根據各區域進行針對性開發與合作。同時，隨著客戶對整合封裝解決方案需求的提升，封裝業務亦將逐步展現動能，持續為公司挹注營收，帶來長期成長契機。

## 營運成果

### 營運成果

(單位: 百萬新台幣)	2025 年第二季	2025 年第一季	增(減) %	2024 年第二季	增(減) %
營業收入淨額	4,512	7,438	(39.3)	2,649	70.3
營業毛利	1,091	1,508	(27.6)	1,249	(12.6)
營業費用	(1,027)	(1,139)	(9.8)	(992)	3.5
營業利益	64	369	(82.7)	257	(75.2)
營業外收入及支出	(19)	86	(122.3)	83	(123.2)
本期淨利(歸屬母公司業主)	26	346	(92.5)	261	(90.1)
基本每股盈餘 (元)	0.10	1.33		1.00	

## 財務報告

### 營業成本、營業費用與營業外收入及支出

(單位: 百萬新台幣)	2025 年第二季	2025 年第一季	增(減) %	2024 年第二季	增(減) %
營業收入淨額	4,512	7,438	(39.3)	2,649	70.3
營業成本	(3,421)	(5,930)	(42.3)	(1,400)	144.3
營業毛利	1,091	1,508	(27.6)	1,249	(12.6)
毛利率 (%)	24.2%	20.3%		47.1%	
營業費用	(1,027)	(1,139)	(9.8)	(992)	3.5
營業利益	64	369	(82.7)	257	(75.2)
營業利潤率 (%)	1.4%	5.0%		9.7%	
營業外收入及支出	(19)	86	(122.3)	83	(123.2)

### 流動資產

(單位: 百萬新台幣)	2025.06.30	2025.03.31	2024.06.30
現金及約當現金	8,372	6,794	9,900
應收票據及帳款淨額	944	2,155	1,088
應收帳款週轉天數	15	20	46
存貨淨額	1,947	2,526	929
存貨週轉天數	29	28	69
流動資產合計	12,016	12,342	12,401

### 負債

(單位: 百萬新台幣)	2025.06.30	2025.03.31	2024.06.30
流動負債合計	5,625	4,963	4,468
應付票據及帳款	1,439	2,245	1,268
其他	4,186	2,718	3,200
非流動負債合計	681	817	697
負債總計	6,306	5,780	5,165
負債/權益比	49.8%	42.2%	39.3%

## 營收分析

### 委託設計營收 (應用別)

應用	2025 年第二季	2025 年第一季	2024 年第二季
通訊網路	7.7%	10.0%	8.9%
行業用	49.2%	30.9%	58.1%
多媒體/消費性電子/ 電腦週邊	2.4%	11.4%	2.5%
HPC & AI	31.6%	24.3%	3.3%
IoT	9.1%	23.4%	27.2%

### 委託設計營收 (製程技術別)

技術	2025 年第二季	2025 年第一季	2024 年第二季
≥0.25um	0.7%	4.1%	0.2%
0.11um~0.18um	4.6%	3.1%	15.4%
55nm~90nm	3.8%	11.2%	9.2%
40nm	10.7%	21.5%	11.3%
28nm	28.5%	31.2%	15.0%
≤14nm	51.7%	28.9%	48.9%

### 量產營收 (應用別)

應用	2025 年第二季	2025 年第一季	2024 年第二季
通訊網路	3.6%	1.5%	8.8%
行業用	9.7%	5.7%	26.1%
多媒體/消費性電子/ 電腦週邊	4.0%	3.3%	11.5%
HPC & AI	60.3%	78.1%	2.2%
IoT	22.4%	11.4%	51.4%

### 量產營收 (製程技術別)

技術	2025 年第二季	2025 年第一季	2024 年第二季
≥0.25um	0.3%	0.3%	1.1%
0.11um~0.18um	3.8%	2.3%	10.6%
55nm~90nm	19.6%	11.0%	58.1%
40nm	12.8%	7.2%	17.3%
28nm	3.3%	1.2%	12.9%
≤14nm	60.2%	78.0%	-

### 總營收 (產品別)

產品	2025 年第二季	2025 年第一季	2024 年第二季
量產	84.5%	88.5%	62.6%
委託設計服務	9.1%	6.1%	24.4%
矽智財	6.4%	5.4%	13.0%

## Contact

曾雯如  
財務長兼發言人  
+886-3-5787888

盧昭儀  
投資人關係  
+886-3-5787888 ext. 84588  
ir@faraday-tech.com

### 關於智原

智原科技 (Faraday Technology Corporation, TWSE: 3035) 以提供造福人類、支持永續發展的晶片為使命，持續發展完整的 ASIC 解決方案，包含 2.5D/3D 先進封裝、Arm Neoverse CSS 設計、FPGA-Go-ASIC 與晶片實體設計服務。同時，智原擁有豐富的矽智財資料庫，涵蓋 I/O、Cell Library、Memory Compiler、ARM-compliant CPUs、LPDDR4/4X、DDR4/3、MIPI D-PHY、V-by-One、USB 3.1/2.0、10/100/Giga Ethernet、SATA3/2、PCIe Gen4/3、可程式設計高速 SerDes，及 PCIe Gen4/3 等數百個週邊訊號 IP。更多資訊，請瀏覽智原科技網站：[www.faraday-tech.com](http://www.faraday-tech.com) 或 [LinkedIn](#) 專頁。